

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

安徽龙磁科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：T2026-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议）
参与单位名称	招商基金、长江证券、大成基金、中航证券、交银施罗德、交银基金、华安证券、胤胜资产、建信基金、趣时资产、兴业证券、嘉实基金、华创证券、友邦保险资管、浙商证券、富国基金、中信建投、易方达、平安资管、天风证券、上海保银、中金、喜世润投资、名禹资产、歌汝资产、煜德投资、天锐投资、上海合远、中泰证券、中银三星人寿、工银瑞信、中汇基金、彤源投资、国投证券、国寿安保、国寿资产、江西中锡、华夏基金、中欧基金、广发基金、国泰基金、兴全基金、国海富兰克林、中再资产、中银基金、太平养老、申万菱信
时间	2026年6月30日-2026年7月15日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理 冯加广 证券事务代表 王慧
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司永磁铁氧体产品的应用领域及技术优势 答：永磁铁氧体湿压磁瓦具有温度适应性好、耐腐蚀等优异特性，是永磁微特电机核心部件，主要应用于汽车、变频家电、电动工具等各类电机。公司70%以上产品销往汽车领域，用于汽车启动电机、雨刮器电机、摇窗电机、电动座椅、ABS电机、风机电机等。公司在永磁铁氧体领域拥有近30年的深厚技术积累，研发实力处于行业领先地位。自主研发的高性能磁瓦性能水平和加工精度处于行业前列，可满足汽车电机高质量、标准化、一致性的严格需求。目前公司已拥有300余项国家专利，覆盖原料制备、磁路优化、高温烧结、模压制造等核心环节，形成了完整的自主知识产权体系。 2、请简要介绍下公司切入电感行业的想法和契机 答：公司立足材料基因，充分发挥软磁材料与主业永磁在生产工艺、技术原理上的高度同源性，沿“材料-器件”一体化路径向下游高附加值环节延伸。依托在金属软磁粉末及磁芯制备领域的积淀，以及车规级客户的渠道优势，2024年与国际头部半导体电源厂商达成战略合作，聚焦AI服务器三级电源管理场景，率先开发用于垂直供电架构的高性能芯片电感，通过深度技术磨合与严格的可靠性验证，2025年1月竞标成功，标志着公司从磁材专家向高端功率器件解决方案提供商的战略跨越正式落地。此后，

公司持续深耕算力产业链，在与多个国际客户合作稳步推进的同时，国内业务市场开拓成效显著，已成功切入数家国内半导体电源模块供应链并实现批量交付。

3、芯片电感市场前景展望

答：芯片电感市场前景广阔，主要驱动因素包括：（1）芯片出货量持续增长：随着芯片整体出货量提升，带动电感用量同步增长；（2）芯片功率不断提高，电感用量增加：单颗芯片功耗不断攀升，为保证供电稳定性，所需匹配的电感数量随之增加；（3）单颗电感价值量提升：高功率、高性能芯片对电感的性能要求也更高（如小型化、耐大电流、低损耗等），进一步推动单颗电感价值量上升。

4、当前芯片电感行业的主要竞争格局以及公司具有哪些竞争优势

答：目前，芯片电感市场主要由中国台系企业占据近半数份额，其余份额由日系及中国大陆厂商覆盖。日系供应商当前产能扩充较慢，大陆企业正加速提升市场占有率。公司通过“材料自研降本、车规客户提质、敏捷研发增效”的三维驱动，正逐步确立在高端芯片电感领域的优势竞争地位。（1）材料自研：依托近三十年的磁性材料技术积淀，公司已实现芯片电感核心原料金属软磁粉的自主研发与生产。这种“材料+器件”的一体化布局，不仅确保了上游供应链的绝对安全，更赋予了我们根据客户需求灵活调整材料配方的能力，从而在饱和电流、损耗等关键性能指标上实现精准调控，构筑材料壁垒。（2）客户壁垒：公司深耕汽车产业链多年，已与国内外头部车企及Tier1供应商建立了长期、稳定的深度互信关系。车规级认证周期长、标准严苛，对产品良率与供应稳定性近乎苛刻。成功通过这一体系认证并保持长期批量供货，不仅验证了公司的质量管控能力，更为关键的是为公司在导入AI服务器、高端工业等新赛道时提供了极强的信用背书。这种经过严苛场景验证的“交付可靠性”，大幅降低了新客户的验证顾虑与导入成本，使公司能够迅速实现跨领域的市场渗透，建立起难以撼动的客户粘性。（3）敏捷研发：依托短链路决策机制，公司展现了远超日系同行的响应速度。我们具备“客户需求当日反馈、设计方案快速迭代”的协同能力，能够紧跟AI算力、自动驾驶等前沿技术的迭代节奏，与客户进行联合研发与同步设计。快速响应能力极大地增强了客户粘性，使我们从单一供应商升级为客户信赖的技术合作伙伴。

5、如何看待电感行业的产能瓶颈及对公司的影响？

答：当前电感行业呈现显著的“低端过剩、高端紧缺”结构性分化。消费级通用品深陷产能红海，而AI算力服务器等高端赛道则因“材料配方+精密设备+客户认证”三重壁垒高筑，供需紧平衡持续加剧。市场数据已印证这一趋势，台系龙头交期拉长至20-26周，订单能见度延伸至2028年。在此背景下，国产替代已从可选项转变为供应链安全的必选项。行业高景气周期为公司拉开了关键的战略窗口。 预计本轮高端电感的紧平衡状态将持续至2027年，这正是公司蓄势突破、抢占高地的核心机遇期。面

	对行业竞争逻辑从“拼产能规模”向“材料配方+高端制造+客户协同”的深刻转变，公司将充分发挥“材料+器件”的垂直整合优势，全速推进高端产能建设。一方面以磁性材料为“压舱石”稳固基本盘，另一方面将芯片电感打造为增长的“新引擎”。通过加速芯片电感产能释放与客户验证，确立更具优势的市场地位。 6、公司芯片电感属于标准化产品吗？公司高端电感产品开发进展 答：公司的芯片电感偏定制化。我们会依据客户对电感值、高频损耗控制、宽温域适应性、电磁兼容性等关键参数的具体要求，进行定向设计与开发。每款产品从方案设计、样品试制到性能验证，均需经过严格的测试与可靠性验证，方可进入批量生产及交付阶段。公司开发的芯片电感涵盖了不同电感值、尺寸规格及工艺路线，能够灵活满足各类客户的多样化需求。目前，公司芯片电感产品已获得国内外多家头部电源厂商认证并实现批量出货。在高端产品方面，公司自主研发的高端多相电感完成测试验证并进入小批量交付阶段。该产品在功率密度、损耗控制等指标上均达到较高水平，能够有效满足高性能算力服务器对供电系统的严苛要求。未来，公司将持续推进高端产品线的拓展与迭代，进一步巩固在高端电感领域的技术优势和先发地位。 7、公司募投项目的进展情况如何 答：公司本次定增募集资金除用于补充流动资金及偿还银行贷款外，主要投向越南龙磁二期工程和芯片电感项目。目前，越南龙磁二期工程的相关厂房规划设计工作已完成，正在办理ODI（境外直接投资）备案手续；芯片电感项目方面，厂房及部分产线已建设完成，初步形成规模化量产能力，依据客户订单及交付计划实施排产，产能扩张与人员梯队建设正有序推进。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年7月15日